

ASMP enabling the
digital world



SIPLACE TX

为智慧工厂提供最佳性能

SIPLACE TX——完美的机器 为智慧工厂而生

智慧工厂需要智能机器：SIPLACE TX配备的全新CP20贴装头以及全新的Xi智能供料器，再一次刷新了其性能表现。

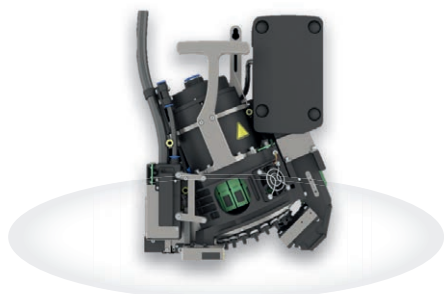
有了新的SIPLACE托盘单元和两个固定的高端相机系统，SIPLACE TX现在也可以用作节省空间的线端机器。它配备了带有唯一识别码的智能吸嘴，还具备自动学习元件间距等功能，凭借这些，树立了新的行业标准。

模块化，灵活，开放——SIPLACE TX通过标准接口和越来越多的自动化选项，无缝地融入ASMPT的开放式自动化概念并用于集成化智慧工厂，作为最先进的高性能产品，适用于各种类型的电子生产。



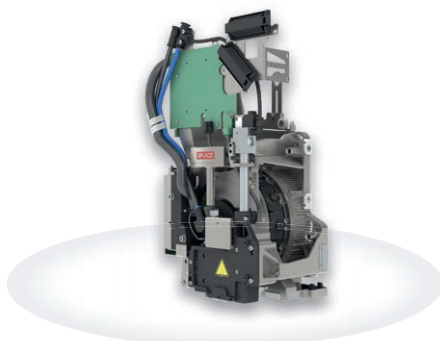
与众不同的 贴装头

3种创新的贴装头提供性能，灵活性和平衡



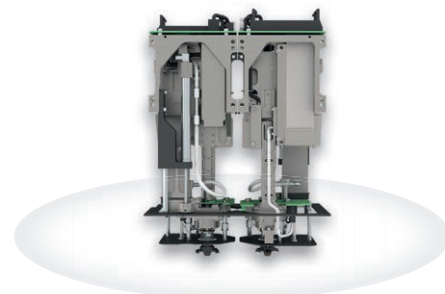
CP20贴装头

- 48,000 cph – 对最大到8.2 mm x 8.2 mm的元器件贴装达到了新的速度标杆
- 贴装精度高：±25 μm
- 最高精度：新的元器件相机是为了更好的图像与更高的分辨率



CPP贴装头

- 3种贴装模式：收集贴装、拾取贴装、及混合模式贴装
- 元器件范围高达50 x 40mm和最大高度可达15.5mm



TWIN贴装头

- 元器件高度可达25mm
- 可用于贴装大型元器件 200 mm × 110 mm

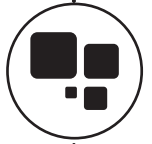
智慧灵活性和 智慧性能



最大产能最小占地面积
96,000 cph, 机器尺寸只有1 m x 2.23 m



极大的元器件范围
元器件大小从0.12 mm × 0.12 mm到
200 mm × 110 mm仅仅3个贴装头就可以全部覆盖



智能成像系统
每个元器件独立成像, 元器件特定光源参数设定,
PCB检测, 异型元器件贴装, 裂纹检测以及更多。



灵活的轨道
双轨和长板选项,
以及高度灵活的PCB传送选择。



非接触式贴装/低压力贴装
非接触式贴装及贴片压力低至0.5 N



精准元器件上料
80 × 8 mm供料器, 点胶供料器,
SIPLACE智能供料器Xi, 线性浸渍单元



SIPLACE料盘单元和 JEDEC料盘

在紧凑的机柜里通过JEDEC和
宽料盘快速和不间断的元器件供给



智能 和集成

WORKS软件套件

凭借强大的WORKS软件, 您可以最大限度地利用您的生产线和SIPLACE TX, 同时减少员工的工作量, 控制和优化您的生产和物料流。AMR车队管理应用程序和企业解决方案(如MES和ERP软件)可以轻松连接。

关于SIPLACE TX
的更多信息, 请扫描



SIPLACE TX

机器类型	SIPLACE TX2i (item No. 588300)	SIPLACE TX2 (item No. 588302)	SIPLACE TX1 (item No. 588301)
贴装速度 (基准速度)	高达96,000 cph	高达85,500 cph	高达43,000 cph
机器尺寸 (长 x 宽 x 高)	1.00 m x 2.23 m x 1.45 m	1.00 m x 2.47 m x 1.45 m	1.00 m x 2.35 m x 1.45 m
贴装头	CP20贴装头, CPP贴装头, TWIN贴装头		
元器件范围	0.12 mm x 0.12 mm至200 mm x 110 mm**		
PCB尺寸 (长 x 宽)	50 mm x 45 mm至590 mm* x 260 mm (双轨) 50 mm x 45 mm至590 mm* x 460 mm (单轨模式)		
供料方式	高达80x8mm供料器, JEDEC料盘, 线性浸渍单元, 点胶供料器, 压力验证供料器, SIPLACE料盘单元		
耗电量	2.0 KW (配备真空泵) 1.2 KW (不配备真空泵)		
耗气量	120 NI/min (配备真空泵)		70 NI/min (配备真空泵)

* 长板选项 (非长板选项时, PCB最大长度为375 mm)

** 有限制条件

贴装头	Placement Head CP20	Placement Head CPP	Placement Head TWIN
元器件范围	0.12 mm x 0.12 mm 至8.2 mm x 8.2 mm	01005至50 mm x 40 mm	0201至200 mm x 110 mm
元器件高度	4 mm	15.5 mm	25 mm
贴装精度(3 σ)	25 μ m	34 μ m	22 μ m
最佳性能 (基准速度)	48,000 cph	25,500 cph	5,500 cph
贴装压力	0.5 N至4.5 N	1.0 N至15 N	1.0 N至30 N

通过ASMP T推荐的适当间隔和范围内的专业维护, 确保您的SIPLACE设备在整个产品周期内实现预定的性能和精度。我们的多种维护合同会让您的工作更简单。

ASMP T

先进装配系统有限公司

上海市东育路227弄3号前滩世贸中心二期C栋3层 | 电话: +86 21 58873030 | E-mail: smt-solutions.cn@asmpt.com

asmpt.com | smt.asmpt.com

17/03-2025版 | 保留所有权利 | 订购号: A22-ASMP T-A327-ZH | 中国印刷 | ©ASMP T GmbH & Co.KG

本手册中的所有信息和插图均以“概不保证”的方式提供, 不含任何明确或隐含的担保, 包括但不限于对质量满意、适用于特定用途和/或正确性的隐含担保。

本手册的内容仅供参考, 不构成建议, 如有更改, 恕不另行通知。ASMP T在法律允许的最大范围内, 对本手册中包含的内容、细节、规格或信息的正确性、准确性、充分性、实用性、及时性、可靠性或其他方面的使用不作任何保证或声明。请联系ASMP T以获取最新信息。仅在达成协议的情况下, 特定性能特性和/或功能才具有法律效力。

所有产品名称均为ASMP T或其他供应商的品牌或者商标。第三方使用需经所有者授权。